

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 20260121

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金：王贵重、何鸣晓、彭民、孟丽婷、赵钰、陈俊杰、刘畔、安昊、吴振坤、吴悠、常蓁、陈涛、归凯、孟夏、李涛、黄福大、左勇，华源证券：白宇，共 18 名投资者及证券人员
时间	2026 年 1 月 21 日上午 9:00~10:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待人员姓名	2026 年 1 月 21 日上午 9:00~10:30：总经理朱顺全先生、董事会秘书杨平彩女士、投资者关系总监熊亚威先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>公司介绍：</b></p> <p>公司是国内领先的关键赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、打印复印通用耗材业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务。此外，在打印复印通用耗材业务板块，公司全产业链布局，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司在该行业内的竞争优势地位。</p> <p><b>问 1：公司 CMP 抛光垫业务作为国产龙头，核心竞争优势主要体现在哪些方面？</b></p> <p><b>答：</b>公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商，核心竞争优势主要体现在四个方面：一是产品型号齐全，覆盖硬垫、软垫，可匹配不同客户的多样化需求，产品型号覆盖率处于国内领先水平；二是核心原材料自主化，已全面实现 CMP 抛光硬垫核心原材料的自主制备，保障产品品质可控及供应链安全，同时带来一定成本优势；三是技术迭代速度快，应用节点覆盖下游客户端所有制程，能够同步匹配下游</p>

客户的技术升级需求；四是具备系统化服务能力，搭配 CMP 抛光液、清洗液形成一站式 CMP 材料解决方案，技术服务响应速度快，客户合作黏性强，国产供应龙头地位稳固。

**问 2：公司半导体显示材料业务中，YPI、PSPI 产品表现优异，新产品验证进展是否符合预期？**

**答：**公司在 OLED 新型显示材料领域占据国内领先地位，YPI、PSPI 产品的市场地位持续稳固，客户主要覆盖国内主流 OLED 面板厂，建立了长期稳定的合作关系，复购属性强，为公司带来持续稳定的现金流。此外，TFE-INK 产品已在客户端规模销售，市场突破成效显著。产能方面，仙桃产业园年产 1000 吨 PSPI 产线已投产并持续批量供应，年产 800 吨 YPI 二期项目作为新增产能补充，可充分满足现有及潜在客户订单需求。新产品方面，无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPDL）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK）等正按计划推进客户验证工作，目前验证进展符合预期；同时，PI 取向液的产品开发持续推进，在客户端的验证、导入已全面展开，多款新一代 OLED 显示材料的创新研发及送样验证，目标填补相关领域空白。

**问 3：公司研发投入持续增加，请问研发投入具体情况及 2026 年研发重点是什么？**

**答：**研发投入的增加主要系 CMP 抛光液、高端晶圆光刻胶业务对产品型号系统布局的要求较高，以及半导体先进封装材料等新业务的投入。2026 年，公司将继续保持高水平的研发投入规模，优化研发资源配置，研发重点主要聚焦于三大方向：一是深化 CMP 相关材料研发，推进 CMP 抛光液多系列产品完善，加快铜及阻挡层抛光液、搭载氧化铈研磨粒子的抛光液等产品的验证及放量；二是推进高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料的产业化进程，加快相关产品的客户验证及市场开拓；三是持续推进半导体显示材料新产品研发，同步跟进下游客户技术升级需求，巩固显示材料领域的领先优势。

**问 4：目前宏观经济及行业形势变动，对公司带来的机遇是什么？**

**答：**当前宏观经济及行业形势变动下，各类发展机遇集中显现，为公司未来快速增长提供了坚实支撑、创造了广阔空间，核心机遇主要体现在四个方面：一是 AI 产业快速发展持续驱动下游半导体芯片及高端显示面板需求扩容，直接带动上游半导体材料、显示材料市场规模稳步增长，公司核心产品精准契合下游增长需求，将持续受益于行业需求红利，实现销量与收入的双重提升；二是全球半导体产业链供应链重构背景下，客户对供应链稳定性、安全性的需求大幅提升，公司核心原材料自主化优势显著，可充分保障产品供应的连续性与可控性，能够更好地契合客户核心诉求，进一步扩大客户合作范围、提升合作深度；三是大硅片、先进封装等新兴领域快速崛起，持续打开半导体材料的增量市场空间，公司提前布局相关配套材料研发与生产，可率先抢占市场先机，培育新的增长动能，为业绩快速增长注入新活力；四是半导体及新型 OLED 显示行业整体保持增长态势，叠加公司核心产品市场渗透率持续提升，核心业务放量节奏加快，同时公司前期孵化的新业务逐步

	<p>进入收获期，各类业务协同发力，将持续推动公司整体规模快速扩张、盈利能力稳步提升，为未来高速增长奠定坚实基础。</p> <p><b>问 5：公司 CMP 抛光垫、半导体显示材料放量速度较快，当前产能是否存在瓶颈，后续产能布局规划如何？</b></p> <p>答：公司前瞻性进行产能布局，目前整体产能能够满足现有订单需求，未出现明显产能瓶颈。具体来看，CMP 抛光垫方面，武汉本部抛光硬垫产线产能至 2026 年一季度预计提升至月产 5 万片左右（即年产约 60 万片），为未来进一步放量销售做好了产能储备，后续将根据市场需求及订单情况，适时优化产能布局。半导体显示材料方面，仙桃产业园年产 1000 吨 PSPI 产线已投产并持续批量供应，产能布局及生产体系能力持续提升；年产 800 吨 YPI 二期项目作为新增产能补充，可充分满足现有及潜在客户订单需求，以缓解武汉本部 YPI 一期产能压力，满足未来持续增长的产品订单供应。后续公司将持续跟踪下游需求变化，动态调整产能规划，确保产能与市场需求精准匹配。</p> <p><b>问 6：公司在光刻胶领域布局全面，目前该业务的核心优势及未来放量前景如何？</b></p> <p>答：公司作为国内成功开发出晶圆光刻胶、封装光刻胶和显示光刻胶三大类光刻胶的企业，在该领域具备显著的综合优势和发展潜力。核心优势主要体现在三点：一是技术实力雄厚，组建了优秀的专业技术团队，历时多年攻关打破国际技术壁垒，相关产品各项关键参数优秀，部分指标达到领先水平；二是产品矩阵完善，覆盖半导体制造、封装及显示全场景需求，可匹配下游不同客户的多样化应用场景；三是量产能力成熟，建成了显示 PSPI 评价实验室、封装光刻胶评价实验室和晶圆光刻胶评价实验室，分别在武汉、潜江、仙桃提前做好产能储备，能够快速响应客户订单需求。未来，随着下游半导体、OLED 显示行业持续发展，光刻胶市场需求将稳步扩容，公司将加快推进各类光刻胶产品的客户验证及市场开拓，进一步提升市场渗透率，助力该业务成为公司又一核心业绩增长极，发展前景广阔。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 21 日